

Überbrückung der Lücke zwischen OSP und metallischer Endoberfläche

PRODUCT
Image
Unavailable



Das richtige Verhältnis zwischen Kosten und Performance zu finden, ist in allen Bereichen der Leiterplattenlieferkette ein Balanceakt. Der letzte Verfahrensschritt, der nur einen Bruchteil von einem Prozent der gesamten Leiterplattenkosten ausmacht, ist der Verfahrensschritt, der